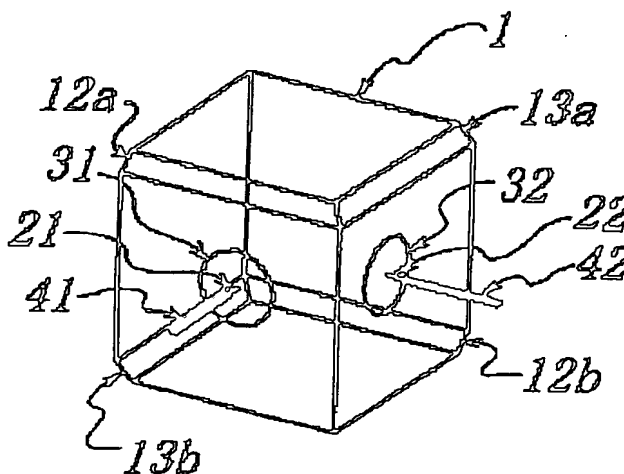


Patent Abstracts of Japan

TITLE : BAND PASS FILTER DEVICE



COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-148810

(43) 公開日 平成9年(1997)6月6日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 P	7/10		H 0 1 P	7/10
	1/20			1/20
	1/208			1/208
				A
				A

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平7-301234

(22) 出願日 平成7年(1995)11月20日

(71) 出願人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72) 発明者 石飛 徳昌

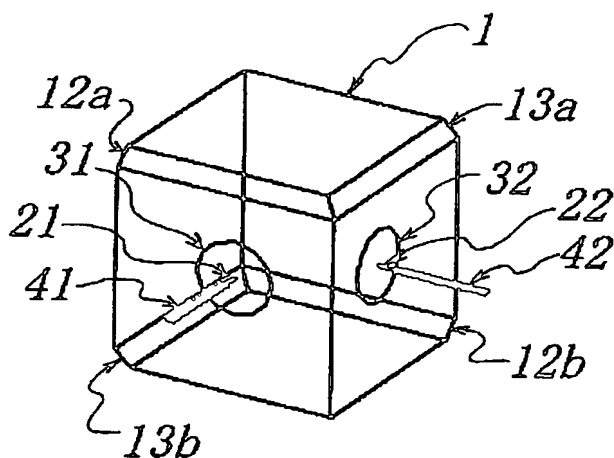
東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー
ディーケイ株式会社内

(54) 【発明の名称】 バンドパスフィルタ装置

(57) 【要約】

【課題】 単一の機械構造で二つ以上の共振モードを持ちながら容易に製造できる共振器を用いたシールドされたバンドパスフィルタを提供することを目的とする。

【解決手段】 以上の様に構成された請求項1および2記載のバンドパスフィルタ装置は、先ず外部回路と第一の共振モードが第一の外部結合手段によって結合され、次に第一の共振モードと外部回路と接続されていない第二の共振モードが結合され、さらに前記第二の共振モードは第三の共振モードと結合され、第三の共振モードが第二の外部結合手段によって外部回路と結合されているので、結果的に三つの共振器を連続的に接続した3段階バンドパスフィルタ装置としての作用をする。しかも機械構造的には周囲を導体で囲まれた実質的には立方体の空洞、若しくは誘電体で満たされ周囲を導体で囲まれた構造なので、その製造にあたっては単なる金属の箱もしくは立方体形状の誘電体の表面に金属をメタライズすることで容易に製造する事ができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 周囲を導体で囲まれた実質的には立方体の空洞の三組みの対向する金属壁に垂直な方向の電界を生ずる三つのTE共振モードを有する共振キャビティにおいて、前記共振キャビティの三つのTE共振モードのうち少なくとも二つの共振モードのそれぞれと外部回路とを結合する外部結合手段を備え、前記外部結合手段を備えた第一の共振モードと第三の共振モードは互いに実用上無結合状態にあり、外部回路と接続された第一の共振モードと外部回路と接続されていない第二の共振モードを結合する結合手段と、外部回路と接続された第三の共振モードと外部回路と接続されていない第二の共振モードを結合する結合手段とを備えたことを特徴とするバンドパスフィルタ装置。

【請求項2】 内部が誘電体で満たされ周囲を導体で囲まれた実質的には立方体の空間の三組みの対向する金属壁に垂直な方向の電界を生ずる三つのTE共振モードを有する共振キャビティにおいて、前記共振キャビティの三つのTE共振モードのうち少なくとも二つの共振モードのそれぞれと外部回路とを結合する外部結合手段を備え、前記外部結合手段を備えた第一の共振モードと第三の共振モードは互いに実用上無結合状態にあり、外部回路と接続された第一の共振モードと外部回路と接続されていない第二の共振モードを結合する結合手段と、外部回路と接続された第三の共振モードと外部回路と接続されていない第二の共振モードを結合する結合手段とを備えたことを特徴とするバンドパスフィルタ装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、高周波電気回路に関し、特に複数の共振回路を必要とするバンドパスフィルタ装置に関する。

【0002】

【従来の技術】この発明の背景となる従来の共振キャビティの設計法は古くから確立されており、例えばMicrowave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures (1964年出版)の5.11章にその共振モードと寸法の関係、外部回路との結合手段について説明されている。ところがこのような共振キャビティでは存在する共振モードのうち最も周波数の低い共振モードのみと外部回路と結合して利用するのが常であった。

【0003】一方で、ほとんどの高周波電気回路では同一の周波数の独立した複数の共振器を必要とするので複数の共振キャビティを使用しなくてはならず、装置全体の大型化、コスト高を招いていた。特にバンドパスフィルタ装置は同一の周波数の共振器を縦続接続して構成され、かつ共振器自身の損失がバンドパスフィルタの特性を決定付けるのでこの問題は顕著である。そこで機械構造的に単一の共振キャビティが持つ複数の共振モードの共振エネルギーをそれぞれ単独に外部回路と接続す

る事、あるいは各々の共振モードを適切に結合させることができれば、同一性能で装置容積の小型化、若しくは同一容積で高性能化を実現できる。

【0004】この課題を解決する従来技術として例えば特開昭49-131357では概ね正方形のストリップ構造の共振器に存在する互いに直交する二つの共振モードとそれらを結合する手段を用いてバンドパスフィルタを構成する発明が提案されている。しかし乍らストリップ共振器の場合は本質的に二次元構造なので直交する二つの共振モードを有効利用するにすぎず、バンドパスフィルタ装置の様に3個以上の共振器を必要とする場合は機械構造的に独立した複数の共振器を組み合わせる必要があった。またストリップ構造のバンドパスフィルタは周辺の回路と一体平面的に製造するには適しているが、バンドパスフィルタ単体とするには別途シールドケースを施さねばならなかった。

【0005】別の従来技術として特開平5-67905ではシールドされた空間中に互いに直交する3本の誘電体棒を配置し、そこに存在する互いに直交する三つのTM共振モードを利用する発明が提案されている。この場合は前記の従来技術の制限であった二つの共振モードしか利用できないという課題は解決されているが、シールドされた空間に誘電体棒を配置するという構造は前記の従来技術に比べて製造方法が複雑になるという新たな課題が生じる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】上記の従来技術に鑑み本発明では単一の機械構造で二つ以上の共振モードを持ちながら容易に製造できる共振器を用いたシールドされたバンドパスフィルタを提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明に係る請求項1記載のバンドパスフィルタ装置は、周囲を導体で囲まれた実質的には立方体の空洞の三組みの対向する金属壁に垂直な方向の電界を生ずる三つのTE共振モードを有する共振キャビティにおいて、前記共振キャビティの三つのTE共振モードのうち少なくとも二つの共振モードのそれぞれと外部回路とを結合する外部結合手段を備え、前記外部結合手段を備えた第一の共振モードと第三の共振モードは互いに実用上無結合状態にあり、外部回路と接続された第一の共振モードと外部回路と接続されていない第二の共振モードを結合する結合手段と、外部回路と接続された第三の共振モードと外部回路と接続されていない第二の共振モードを結合する結合手段とを備えたことを特徴とする。

【0008】本発明に係る請求項2記載のバンドパスフィルタ装置は、内部が誘電体で満たされ周囲を導体で囲まれた実質的には立方体の空間の三組みの対向する金属壁に垂直な方向の電界を生ずる三つのTE共振モードを有する共振キャビティにおいて、前記共振キャビティ

の三つのTE共振モードのうち少なくとも二つの共振モードのそれぞれと外部回路とを結合する外部結合手段を備え、前記外部結合手段を備えた第一の共振モードと第三の共振モードは互いに実用上無結合状態にあり、外部回路と接続された第一の共振モードと外部回路と接続されていない第二の共振モードを結合する結合手段と、外部回路と接続された第三の共振モードと外部回路と接続されていない第二の共振モードを結合する結合手段とを備えたことを特徴とする。

【0009】(作用)以上の様に構成された請求項1および2記載のバンドパスフィルタ装置は、先ず外部回路と第一の共振モードが第一の外部結合手段によって結合され、次に第一の共振モードと外部回路と接続されていない第二の共振モードが結合され、さらに前記第二の共振モードは第三の共振モードと結合され、第三の共振モードが第二の外部結合手段によって外部回路と結合されているので、結果的に三つの共振器を縦続的に接続した3段バンドパスフィルタ装置としての作用をする。しかも機械構造的には周囲を導体で囲まれた実質的には立方体の空洞、若しくは誘電体で満たされ周囲を導体で囲まれた構造なので、その製造にあたっては単なる金属の箱もしくは立方体形状の誘電体の表面に金属をメタライズすることで容易に製造する事ができる。

【0010】

【発明の実施の形態】

「3段バンドパスフィルタ装置の実施例」

《単一構造の共振器》図4は本発明の3段バンドパスフィルタの一実施例の構造を示す図である。このフィルタは3つの共振器を持つ3段バンドパスフィルタ装置として作用するが、図示の様に単一の共振器構造体からなっている。共振器構造体は、機械構造的に周囲を導体で囲まれた実質的には立方体の空洞、若しくは誘電体で満たされ周囲を導体で囲まれた構造を必要に応じて任意に選択する。

【0011】《共振モード相互の結合手段》図1、図2、図3はそれぞれこの単一の共振器構造体に存在する3つの共振モード姿態をしめしている。実際にこの共振器構造の3辺が完全に同一の長さで且つ直交していればこれらの三つの共振モードは縮退し存在することはできない。しかし次に説明する共振モード相互の結合手段を設けることで複数の共振モードが実質的に結合した作用を得られる。

【0012】〈第一の共振モードと第二の共振モードの結合手段〉

〔同相モード〕図5は図1に示す第一の共振モードと図2に示す第二の共振モードを相互に結合せしめる結合手段を設けたときに、第一の共振モードと第二の共振モードが同相な場合のモード姿態を示す。図6はこのとき電界ベクトルに平行な平面で切った共振器構造体の断面における電界ベクトルの様子を示す。共振器構造体の断面

は正方形の角に面どりを施してある。

〔逆相モード〕図7は図1に示す第一の共振モードと図2に示す第二の共振モードを相互に結合せしめる結合手段を設けたときに、第一の共振モードと第二の共振モードが逆相な場合のモード姿態を示す。図8はこのとき電界ベクトルに平行な平面で切った共振器構造体の断面における電界ベクトルの様子を示す。共振器構造体の断面は正方形の角に面どりを施してある。

〔結合係数〕図6と図8からわかるように、同相モードと逆相モードでは共振器構造体に面どりを施してあることで電界ベクトルの経路長が異なる。従って同相モードと逆相モードではその共振周波数が異なる。同相モードにおける共振周波数を f_{even} 、逆相モードにおける共振周波数を f_{odd} とすると二つの共振モードの結合係数 K は次式であらわされる。

$$K = 2 | f_{\text{odd}} - f_{\text{even}} | / (f_{\text{odd}} + f_{\text{even}})$$

こうして第一の共振モードと第二の共振モードが結合係数 K で結合される。

【0013】〈共振モード相互の結合手段〉この様に図1に示す第一の共振モードと図2に示す第二の共振モードのそれぞれの電界ベクトルに平行な平面で切った共振器構造体の断面形状を正方形でなく、例えば一部の角に面取りを施すなどの方法で図1に示す第一の共振モードと図2に示す第二の共振モードを結合させることができる。図示しないが同様に図2に示す第二の共振モードと図3に示す第三の共振モードのそれぞれの電界ベクトルに平行な平面で切った共振器構造体の断面形状を正方形でなく、例えば一部の角に面取りを施すなどの方法で図2に示す第二の共振モードと図3に示す第三の共振モードを結合させることができる。さらに第三のモードの電界ベクトルと第一のモードの電界ベクトルに平行な平面で切った共振器構造体の断面形状を正方形にすることで第一の共振モードと第三の共振モードは互いに実用上無結合状態にできる。図4に示す実施例では第一の共振モードと第二の共振モードの間の結合手段を設け且つ、第二の共振モードと第三の共振モードの間の結合手段を設けながら、第一の共振モードと第三の共振モードの間には結合手段を設けていないので三つの共振モードが縦続に結合していることになる。もちろん共振モードの間の結合手段はこの実施例の角に面取りを施す方法だけでなく後述する様々な方法を探ってもよいし、異なる方法を組み合わせてもよい。

【0014】《外部結合手段》

〈電気的な外部結合手段〉図9は前記第一の共振モードと外部回路を接続する外部結合手段のうち電気的な結合手段の一例を図示している。図1に示した第一の共振モードの電界ベクトルに垂直な壁面の中央からTEM線路の中心導体を挿入し円形の電極板を設けている。この電極板から共振キャビティ壁面に向かう主たる電界ベクトルは第一の共振モードの電界ベクトル及び第三の共振モ

一の電界ベクトルに垂直なので、第二の共振モードと第三の共振モードには結合しない。しかしこの電極板から共振キャビティ壁面に向かう主たる電界ベクトルは第一の共振モードの電界ベクトルと平行なので第一の共振モードとは結合し、第一の共振モードを外部回路と電氣的に結合する作用をなす。

【0015】〈外部結合手段〉図4に示す本発明の3段バンドパスフィルタ装置の一実施例の構造では第一の共振モードと外部回路を電氣的に結合する外部結合手段と、同様に第三の結合モードと外部回路を電氣的に結合する外部結合手段を設けている。もちろん外部結合手段として後述する磁氣的な外部結合手段を採ってもよいし、第一の共振モードと第三の結合モードで異なる方法を組み合わせてもよい。

【0016】《等価回路》図11は図4に示す本発明の3段バンドパスフィルタの一実施例の集中定数等価回路を示している。この実施例では共振モード相互の結合が結合係数 K_{12} , K_{23} , K_{31} に相当する。実施例では第一の共振モードと第三の共振モードを結合させる手段は設けていないので $K_{31}=0$ である。また入出力端子と第一、第三の共振回路それぞれの間に挿入されたキャパシタは電氣的な外部接続手段に相当する。従って共振モード相互の結合手段によって共振器間の結合量を、外部結合手段によって共振器と外部回路との結合量を、そして共振キャビティの寸法によって中心周波数をそれぞれ適正に調整すれば三段バンドパスフィルタとしての作用をなす。

【0017】《特性例》図12は本実施例の3段バンドパスフィルタの周波数特性である。また図13は本実施例において共振モード相互の結合手段たる角部の面どり寸法 Δs と共振器構造体の辺長 S の比 $\Delta s/S$ とバンドパスフィルタ装置の比帯域幅の関係を示している。

【0018】「磁氣的な外部結合手段の実施例」図10は前記第一の共振モードと外部回路を接続する外部結合手段のうち磁氣的な結合手段の一例を図示している。図1に示した第一の共振モードの電界ベクトルに平行な壁面の中央にTEM線路の中心導体を延長したループコイルを設けている。このループコイルから共振キャビティ内に発生する主たる磁界ベクトルは第二の共振モードの電界ベクトル及び第三の共振モードの磁界ベクトルに垂直なので、第二の共振モードと第三の共振モードには結合しない。しかしこのループコイルから共振キャビティ内に発生する主たる磁界ベクトルは第一の共振モードの磁界ベクトルと平行なので第一の共振モードとは結合し、第一の共振モードを外部回路と磁氣的に結合する作用をなす。

【0019】「共振モード相互の別の結合手段の実施例」共振モード相互の結合手段は前記の共振構造体の断面形状を正方形でない以下の方法でも実現できる。

《平行四辺形にする》例えば図14は共振構造体の結合させようとする共振モードそれぞれの電界ベクトルを含む

断面形状を正方形でなく平行四辺形とした例である。

【0020】《長方形にする》例えば図15は共振構造体の結合させようとする共振モードそれぞれの電界ベクトルを含む断面形状を正方形でなく長方形とした例である。

【0021】《異質な部分を埋めこむ、穴を明ける》例えば図16は共振構造体の結合させようとする共振モードそれぞれの電界ベクトルを含む断面の一部に異質な媒体、例えば異なった誘電率の物質、磁性体、を設けた例である。特にこの媒体として空気を使った場合は単に図示する様な形状の穴を設ければよい。

【0022】《表面の導体に穴を明ける》例えば図17は第一の共振モードと第二の共振モードを結合させるために前記の実施例で一部の角に面どりを施す方法に替えて突起物を設け、さらに第二の共振モードと第三の共振モードを結合させるために前記の実施例で一部の角に面どりを施す方法に替えて表面の導体の一部を切り取った例である。

【0023】

【発明の効果】以上の実施例から明らかなように、本発明によれば、共振モード相互間の結合手段によって共振器間の結合量、外部結合手段によって共振器と外部回路との結合量、共振キャビティの寸法によって中心周波数をそれぞれ適正に調整すれば、単一の共振キャビティと同等の容積で製造容易な3段バンドパスフィルタを提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】TE₁₁₀共振モード姿態を示す図である。

【図2】TE₁₀₁共振モード姿態を示す図である。

【図3】TE₀₁₁共振モード姿態を示す図である。

【図4】三つの共振モードを用いた3段バンドパスフィルタの構造の一例を示す図である。

【図5】結合した二つの共振モードの偶モード姿態を示す図である。

【図6】結合した二つの共振モードの偶モード断面姿態を示す図である。

【図7】結合した二つの共振モードの奇モード姿態を示す図である。

【図8】結合した二つの共振モードの奇モード断面姿態を示す図である。

【図9】外部回路との電氣的結合構造の例を示す図である。

【図10】外部回路との磁氣的結合構造の例を示す図である。

【図11】三つの共振モードを用いた3段バンドパスフィルタの等価回路の一例を示す図である。

【図12】三つの共振モードを用いた3段バンドパスフィルタの特性の一例を示す図である。

【図13】三つの共振モードを用いた3段バンドパスフィルタの面どり寸法と帯域幅の一例を示す図である。

【図14】共振モード相互の結合手段として、結合させようとする共振モードそれぞれの電界ベクトルを含む平面で切った共振器構造体の断面形状を平行四辺形にした実施例を示す図である。

【図15】共振モード相互の結合手段として、結合させようとする共振モードそれぞれの電界ベクトルを含む平面で切った共振器構造体の断面形状を長方形にした実施例を示す図である。

【図16】共振モード相互の結合手段として内部に異なる媒質の部分を設けた実施例を示す図である。

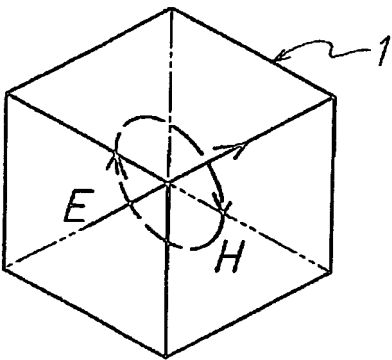
【図17】共振モード相互の結合手段として突起物を設けた実施例及び表面金属を剥離した実施例を示す図であ

る。

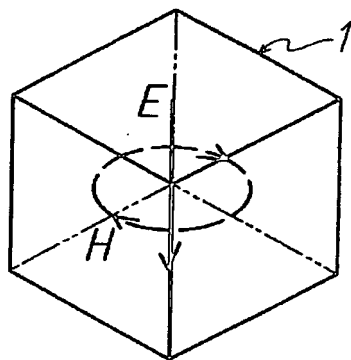
【符号の説明】

- 1 共振器構造体
- 12a, 12b, 13a, 13b 面取り部
- 21, 22 TEM線路中心導体
- 31, 32 電極板
- 41, 42 TEM線路
- 51 ループコイル
- 61 突起部
- 72 導体剥離部分
- 81 異なる媒質の部分

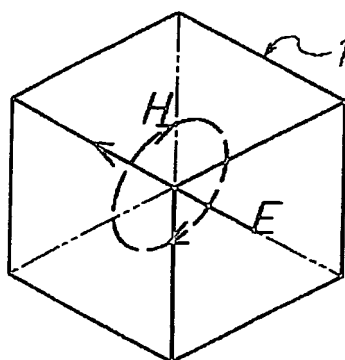
【図1】



【図2】



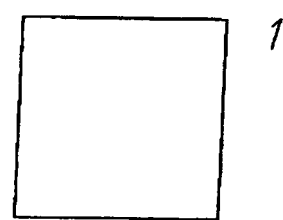
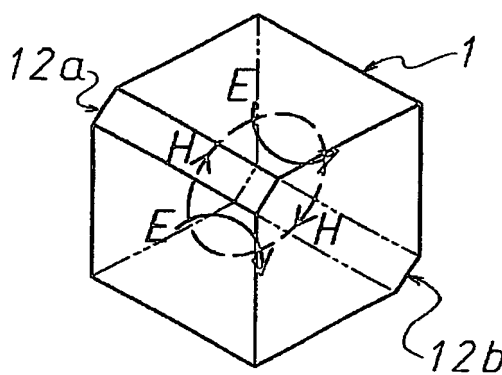
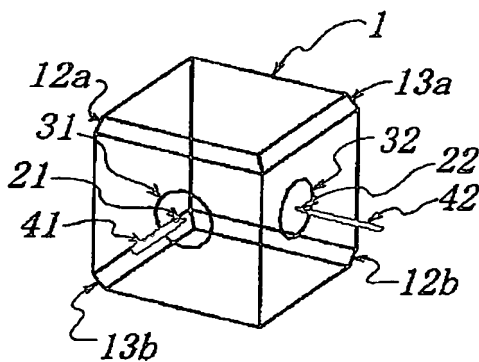
【図3】



【図4】

【図5】

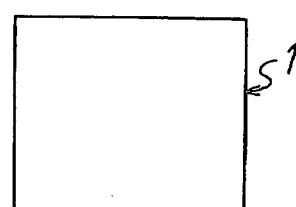
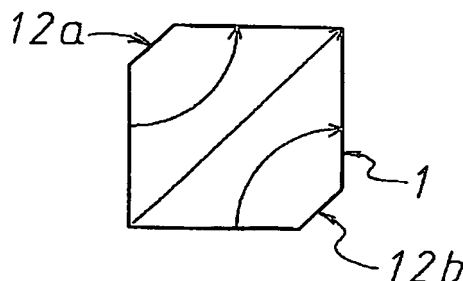
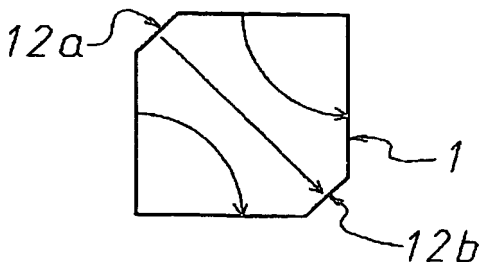
【図14】



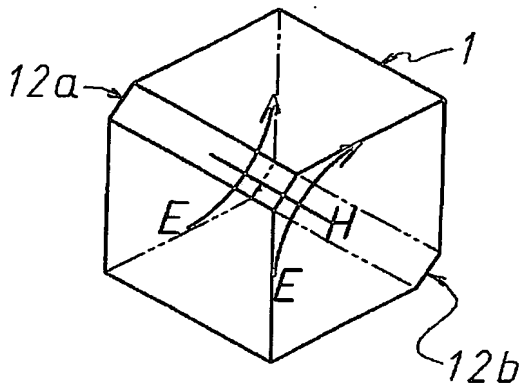
【図6】

【図8】

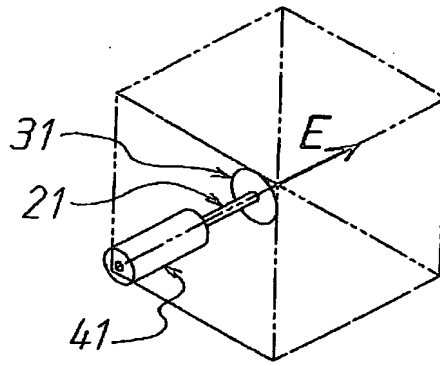
【図15】



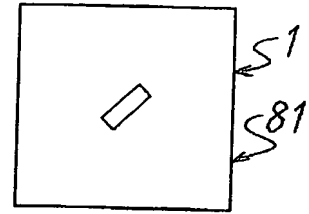
【図7】



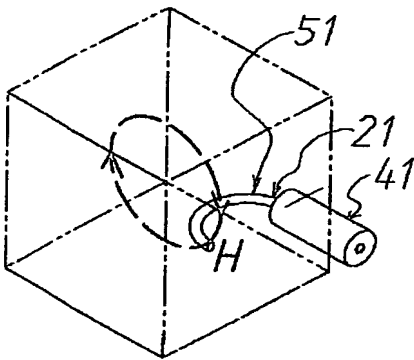
【図9】



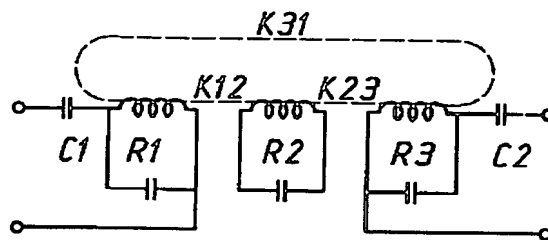
【図16】



【図10】

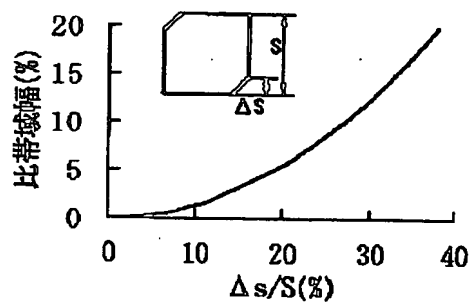


【図11】

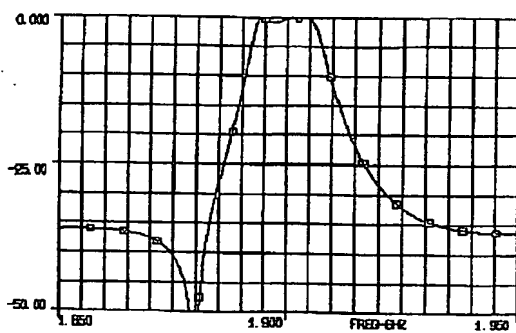


【図13】

縮退分路素子の寸法と帯域幅



【図12】



(7)

特開平9-148810

【図17】

